

開示の要約

研磨装置

- 5 パッド温度を素早く常温よりも低い温度まで低下させることで、研磨レートを精密に制御することが可能な研磨装置が開示される。研磨装置は、研磨パッドを支持する回転可能な研磨テーブルと、基板を回転する研磨パッドの研磨面に押し付けて基板Wを研磨する研磨ヘッドと、研磨面の温度を測定する少なくとも1つのパッド温度測定器と、研磨面の温度を調整するパッド温度調整装置
- 10 と、パッド温度測定器によって測定された研磨面の温度に基づいてパッド温度調整装置の動作を制御する制御装置と、を備える。パッド温度調整装置は、研磨面に冷却剤を噴射する少なくとも1つの冷却ノズルと、研磨面にドライガスを噴射する少なくとも1つのドライガスノズルと、を含む。冷却剤は、雰囲気温度以下の沸点を有する。

15

図 4